

RESOLUCIÓN RECTORAL DE 29 DE FEBRERO DE 2024 POR LA QUE SE HACE PÚBLICA LA ADJUDICACIÓN DE AYUDAS Y BECAS PARA INTERCAMBIOS ACADÉMICOS EN ASIA Y OCEANÍA DURANTE EL AÑO ACADÉMICO 2024-2025

Por Resolución Rectoral de 15 de enero de 2024 se publicó la convocatoria de ayudas y becas para intercambios académicos en Asia y Oceanía durante el año académico 2024-2025.

VISTA la propuesta formulada por la Comisión de Selección en su sesión del día 26 de febrero de 2024.

RESULTANDO que en dicha propuesta se incluye a los adjudicatarios que más abajo se relacionan,

CONSIDERANDO que es facultad del Rector sancionar dicha propuesta y ordenar su publicación en la página web de la UPM,

ESTE RECTORADO HA RESUELTO, adjudicar la concesión de ayudas y becas en las modalidades A, B,C siguientes:

MODALIDAD A: AYUDAS PARA INTERCAMBIOS DE TONGJI.

Las ayudas tienen por objeto cubrir total o parcialmente los gastos de transporte por avión (ida y vuelta), seguro médico y de accidentes y de responsabilidad civil ONCAMPUS y gastos del trámite del visado ordinario (no urgente) hasta un máximo de 1.200 euros en total.

MODALIDAD A: TONGJI 1 semestre			
Apellido	Nombre	Universidad	Escuela
García Rodríguez	Luis	Tongji University	ETSI CAMINOS, CANALES Y PUERTOS
Sanabria Gavin	Paula	Tongji University	ETS DE ARQUITECTURA
Priegue Rodríguez	Gabriela Andrea	Tongji University	ETS DE INGENIERÍA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS
Martínez Mosquera	Isabella	Tongji University	ETS DE ARQUITECTURA
Mulvihill Duque	William Henry	Tongji University	ETS DE ARQUITECTURA
Hernández López	Sofía	Tongji University	ETS DE ARQUITECTURA
Porcar Pérez	Lucía	Tongji University	ETS DE ARQUITECTURA
Rodríguez Berenguel	Juan	Tongji University	ETS DE INGENIERÍA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS
Canseco Gutiérrez	Ana	Tongji University	ETS DE ARQUITECTURA
Rodríguez Ballesteros	Miguel	Tongji University	ETS DE ARQUITECTURA

MODALIDAD A: TONGJI 2 semestre			
Apellido	Nombre	Universidad	Escuela
Varela Toucedo	Juan	Tongji University	ETSI CAMINOS, CANALES Y PUERTOS
Sanchez Torijano	Alejandro	Tongji University	ETS DE INGENIERÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL
Mouton	Emma	Tongji University	ETS DE INGENIERÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL
Guardiola Lohmüller	Jacobo	Tongji University	ETS DE ARQUITECTURA
Rodríguez Vallejo	Adriana	Tongji University	ETSI INDUSTRIALES
Pérez García	Alex	Tongji University	ETS DE INGENIERÍA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS
Sanz Guevara	Juan Diego	Tongji University	ETS DE INGENIEROS INFORMÁTICOS

MODALIDAD B: BECAS PARA INTERCAMBIOS DE LA R.P CHINA, MALASIA, COREA DEL SUR, JAPÓN Y AUSTRALIA

La cuantía de la beca es de tres mil euros (3.000€)

MODALIDAD B: 1 semestre			
Apellido	Nombre	Universidad	Escuela
Wu	Hongfei	Beihang University	ETS DE INGENIEROS INFORMÁTICOS
Domínguez López	Estrella Yong	Keio University	ETSI INDUSTRIALES
Escaño Márquez	Luis	Doshisha University	ETS DE INGENIEROS INFORMÁTICOS
Abellán Martín	Antonio	Beijing Sports University	FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FISICA Y EL DEPORTE (INEF)
López Gallardo	Alex	Doshisha University	FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FISICA Y EL DEPORTE (INEF)
Wang	Yan	Beihang University	ESCUELA POLITECNICA DE ENSEÑANZA SUPERIOR (EPES)
Namer Gutman	Naomí Esther	Korea Advanced Institute of Science and Technology	ETS DE INGENIEROS INFORMÁTICOS
Zhan	Yijian	The University of Tokyo	ETS DE ARQUITECTURA
Padilla Ericksen	Elisa	Osaka Institute of Technology	ETS DE INGENIERÍA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS
Álvarez Capitán	Belén	Beihang University	ETS DE INGENIERÍA AERONÁUTICA Y DEL ESPACIO
Chen Xiang	Zhi	Beihang University	ETSI TELECOMUNICACION
Herráez Alvarez	Carlos	The University of Tokyo	ETS DE ARQUITECTURA
de Neira Ortiz de Urbina	Juan	Keio University	ETSI INDUSTRIALES
García González	Claudia	RMIT University	ETS DE ARQUITECTURA
Gutiérrez Fidalgo	Manuel	Keio University	ETSI INDUSTRIALES
Cuesta Reyes	Tomás	University of Newcastle	ETS DE ARQUITECTURA
Solaun Batarrita	Jon	Doshisha University	ETSI INDUSTRIALES

MODALIDAD B: 2 semestre			
Apellido	Nombre	Universidad	Escuela
Wu	Hongfei	Beihang University	ETS DE INGENIEROS INFORMÁTICOS
Domínguez López	Estrella Yong	Keio University	ETSI INDUSTRIALES
Escaño Márquez	Luis	Doshisha University	ETS DE INGENIEROS INFORMÁTICOS
Tovar Navarro	Pablo	The University of Tokyo	ETS DE ARQUITECTURA
Pardo Bernal	Marina	Tianjin University	ETS DE INGENIERÍA DE MONTES, FORESTAL Y DEL MEDIO NATURAL
Rodrigo Pérez	Guillermo	Tsinghua University	ETS DE INGENIERÍA Y SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN
Artiles Martínez	Maria	Osaka Institute of Technology	ETS DE INGENIERÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL
Sparrowe Ochoa	Guillermo	Osaka Institute of Technology	ETS DE INGENIERÍA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS
García Neira	Nuria	Sichuan Agricultural University	ETS DE INGENIERÍA AGRONÓMICA, ALIMENTARIA Y DE BIOSISTEMAS

MODALIDAD B: SUPLENTE			
Apellido	Nombre	Universidad	Escuela
Rico Castro	Noé	Xian Jiaotong Liverpool University	ESCUELA POLITECNICA DE ENSEÑANZA SUPERIOR (EPES)
Biosca Hernández	Paula	The University of Tokyo	ETS DE ARQUITECTURA
Crespo González	Noelia	Universiti Sains Malaysia	ETS DE INGENIERÍA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS
Xu Zhang	Jiajun	Keio University	ETSI INDUSTRIALES
Martín Villadóniga	Katia	Soochow University	ETS DE INGENIERÍA AGRONÓMICA, ALIMENTARIA Y DE BIOSISTEMAS

MODALIDAD C: BECAS PROGRAMA DE INCUBACIÓN DE EMPRENDEDORES E INNOVADORES DE BASE TECNOLÓGICA DE LA UPM Y PROYECTOS DE INNOVACIÓN EN CHINA

La cuantía de las becas es de 2000 euros cada una

Modalidad C Emprendimiento -1 Semestre			
Apellido	Nombre	Universidad	Escuela
Barbero Ros	Filippo Pablo	Tongji University	ETS DE ARQUITECTURA
Vidaachea Jimenez	Javier	Tongji University	ETSI INDUSTRIALES

Modalidad C Emprendimiento - 2 Semestre			
Apellido	Nombre	Universidad	Escuela
Mateos Budiño	Juan	Tongji University	ETS DE INGENIERÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL
de Armas Álvarez	María	Tongji University	ETSI INDUSTRIALES

La efectiva realización de estas movilizaciones está condicionada tanto al cumplimiento de todos los requisitos señalados en la resolución rectoral de 15 de enero de 2024 como al cumplimiento de las condiciones de seguridad recomendadas por las autoridades competentes, especialmente por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación tanto en el país o región de destino como en países colindantes cuando puedan existir riesgos relacionados con una situación de conflicto interno o internacional.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes desde su publicación, ante el Rector, o bien interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a su publicación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015 y 8 y 46.1 de la Ley 29/1988, de 13 de Julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Madrid ,29 de febrero de 2024.

EL RECTOR,

Fdo.: Guillermo Cisneros Perez